

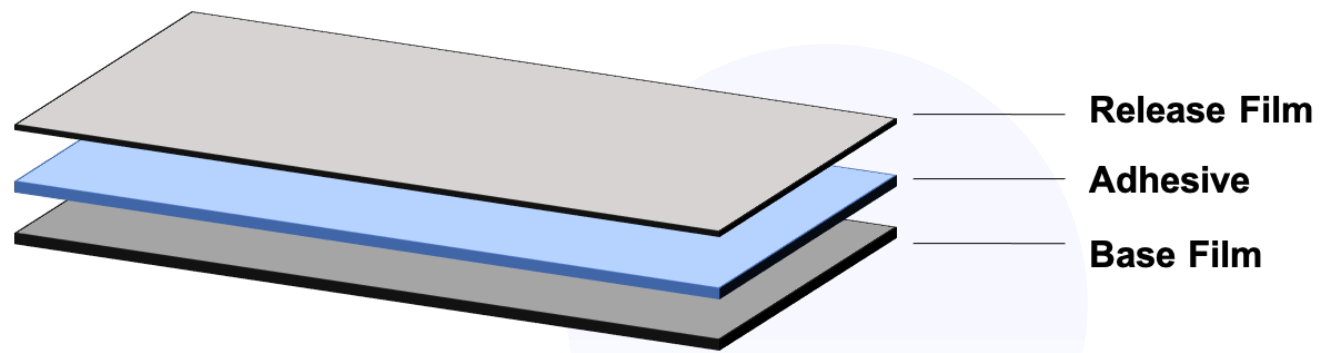
保護膠帶產品介紹

Tel : +886-7-6217681

總公司：高雄市岡山區岡山北路二巷51號

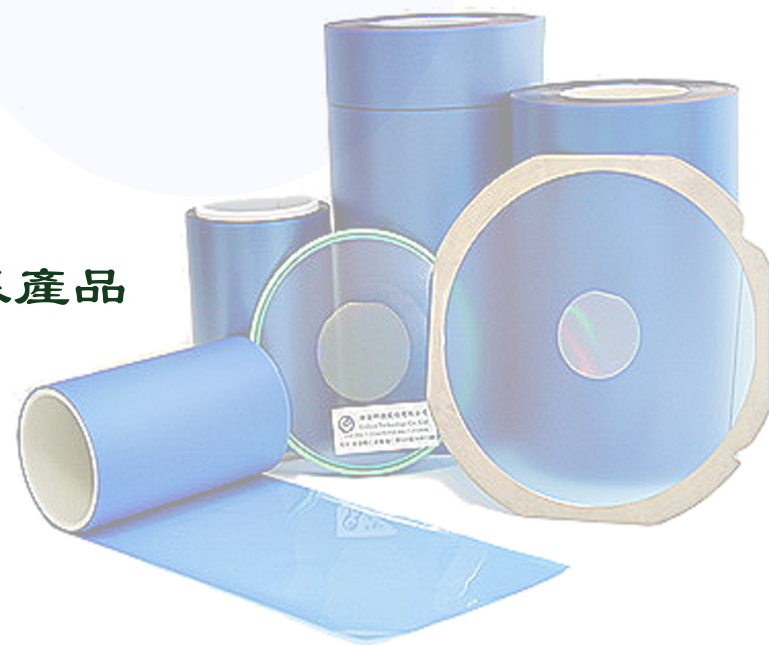
應用 (Application)

- 晶片研磨製程
- 晶片切割製程
- 晶片翻轉製程
- 陶瓷片切割製程



特點 (Feature)

- LED、半導體產業晶圓晶粒切割專用
- 品質特性經國際大廠驗證及使用，穩定性媲美日系產品
- 特殊黏膠配方，黏著力適中，加工製程後無殘膠
- 適用於LED晶粒翻轉製程，無晶粒飛失現象
- 膠膜平整柔軟易擴充及頂取



型號 Model	底材材質/厚度 Base film material / thickness (um)	膠厚 Adhesive thickness (um)	接著強度 Adhesion (N/25mm)	顏色 Color	使用製程 Process
GVC 935F	PVC / 70	10	0.6	藍色	LED 晶片出貨用
GVC 909		20	2.5		晶片鍍金後 LIFT OFF 用
GVC 929		10	0.8		LED 晶片切割用
GVC 942E	PVC / 90	15	2		晶片/陶瓷片切 割

依您的需求，設計最符合您的客製化材料

Customize your material

Located in Kaohsiung

